

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年7月28日(28.07.2022)



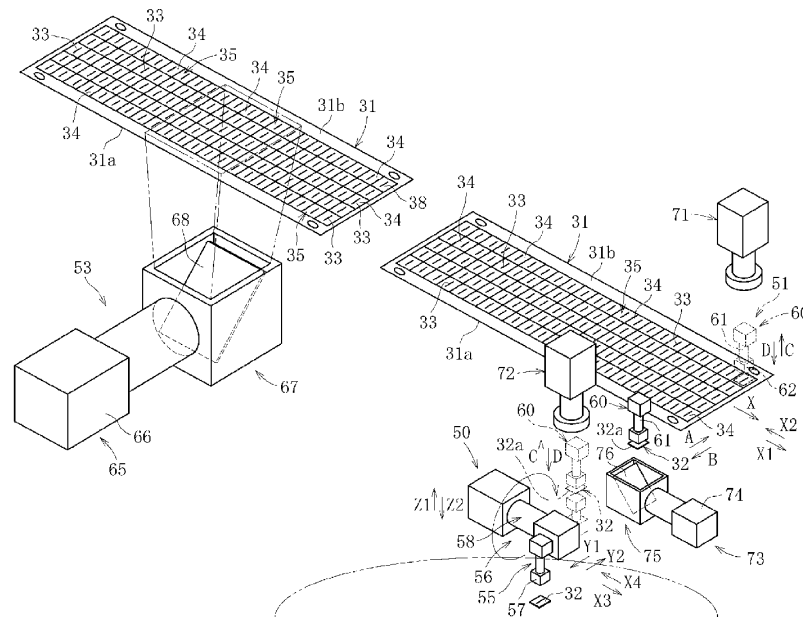
(10) 国際公開番号

WO 2022/158122 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/52 (2006.01) H01L 21/60 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/043808
- (22) 国際出願日: 2021年11月30日(30.11.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-007920 2021年1月21日(21.01.2021) JP
- (71) 出願人: キヤノンマシナリー株式会社(CANON MACHINERY INC.) [JP/JP]; 〒5258511 滋賀県草津市南山田町字縄手崎85番地 Shiga (JP).
- (72) 発明者: 永元 信裕 (NAGAMOTO Nobuhiro); 〒5258511 滋賀県草津市南山田町字縄手崎85番地 キヤノンマシナリー株式会社内 Shiga (JP).
- (74) 代理人: 城村 邦彦, 外(SHIROMURA Kunihiro et al.); 〒5410059 大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号 江原特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,

(54) Title: BONDING METHOD AND BONDING DEVICE USE METHOD

(54) 発明の名称: ボンディング方法およびボンディング装置使用方法



(57) Abstract: In this bonding method, a substrate, which has a wire insertion hole that penetrates therethrough in the thickness direction and in which a positioning reference mark is formed on a pattern formation surface side, is conveyed from the upstream side to the downstream side along a substrate conveyance path, and at a downstream-side bonding position on the substrate conveyance path, an electrode formation surface of a chip is bonded to a chip bonding section of a chip bonding surface which is on the side opposite the pattern formation surface of this substrate.

[続葉有]

WO 2022/158122 A1

MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 厚さ方向に貫通したワイヤ挿通孔を有しかつパターン形成面側に位置決め用基準マークが形成された基板が、基板搬送路に沿って上流側から下流側へ搬送され、基板搬送路の下流側のボンディングポジションで、この基板におけるパターン形成面の反対側のチップ接合面のチップ接合部に、チップの電極形成面を接合するボンディング方法である。